Pressemitteilung

**tML-Systemplattform mit SN-Einzelfasersteckverbinder ab sofort verfügbar**

**tML LWL-SN-Modul: High-Density im Patchbereich mit 384 Fasern auf einer Höheneinheit**

**Dortmund, 12. Januar 2022. Die tde – trans data elektronik stellt als erster Netzwerkexperte ein LWL-SN-Modul für ihre erfolgreichen Verkabelungsplattformen tML-Standard, tML24 und tML-Xtended bereit. Dafür hat die tde den kompakten SN-Steckverbinder von Senko in ihre tML-Systemplattform integriert. Das Ergebnis: Mit 384 Fasern auf einer Höheneinheit im Patchbereich verdoppelt sich die Packungsdichte gegenüber LC-Duplex-Steckverbindern. Unternehmen und Netzwerktechniker sparen so wertvollen Platz in Rechenzentren. Im Rückraum setzt das neue Modul auf die bewährte MPO-Technologie mit Plug-and-play-Funktionalität.**

Mit dem neuen tML LWL-SN-Modul unterstreicht die tde ihren Innovationsanspruch, Kunden immer die branchenweit höchste Packungsdichte zu bieten: Der Technologie-Pionier und langjährige und vertrauensvolle Partner von Senko kombiniert den Vorteil des hoch kompakten SN-Einzelfasersteckverbinders mit ihren tML-Systemen. Indem Kunden bestehende tML-Systeme mit LC-Duplex-Modulen problemlos gegen LWL-SN-Module tauschen und aktualisieren können, erhalten sie die derzeit am Markt höchste Packungsdichte mit Einzelfasersteckverbindern. „Die Anforderungen an Data Center sind enorm: Neben immer höheren Übertragungsraten, höchster Packungsdichte und besserer Verwaltbarkeit müssen sie auch den vorhandenen, wertvollen Platz optimal nutzen und dem Aspekt der Green IT Rechnung tragen. Mit dem neuen LWL-SN-Modul bieten wir Rechenzentren jetzt eine innovative Lösung für High-Density-Anwendungen und zukunftssichere Highspeed-Netzwerke mit Übertragungen von bis zu aktuell 400G“, sagt André Engel und fährt fort: „Das tML LWL-SN-Modul steigert die Packungseffizienz unseres skalierfähigen tML-Systems im Patchbereich nochmals deutlich.“

*tML LWL-SN-Modul spart teure Fläche für mehr Green IT*Dank der kompakten Bauform des SN-Steckverbinder finden 24 x LWL-SN-Steckverbinder mit 48 Fasern in einem tML-Modul sowie 192 x 2 Fasern mit insgesamt 384 Fasern auf einer 19-Zoll-Höheneinheit Platz. „Das ist eine Verdoppelung der Packungsdichte im Vergleich zur Verwendung von LC-Duplex-Steckverbindern.“ erläutert André Engel. „Diese Packungseffizienz gewährleisten wir im Übrigen auch mit unserem im vergangenen Jahr eingeführten tML LWL-MDC-Modul.“   
  
  
  
  
Zudem ermöglicht das neue tML LWL-SN-Modul eine Vervierfachung der Portdichte gegenüber dem Branchenstandard. Im Rückraum setzen die tML-Module auf die bewährte MPO-Technologie. Dabei bindet das tML24-System zwei 24-Faser-MPOs ein. Daraus resultieren drastische Einsparungen an teurer Fläche, die zudem nicht klimatisiert werden muss, verbunden mit einem Mehr an Green IT.

*Für Breakout-Anwendungen designt*  
Den sehr schmal designten Steckverbinder auf Basis der bewährten 1,25-mm-Ferrulen-Technologie hat Senko für die neue Generation der High-Density-Transceiver OSFP (Octal Small Format Pluggable) und QSFP DD (Quad Small Form Factor Pluggable Double Density) mit Übertragungsraten von bis zu 400G ausgelegt. Netzwerktechnikern eröffnen sich damit Optionen für Breakout-Anwendungen, indem sie die Übertragungsraten in Kanäle mit niedrigerer Kanalgeschwindigkeit aufteilen. Dadurch lassen sich die Chassis der aktiven Komponenten mit höheren Portzahlen und Packungsdichten effizienter nutzen. „Wir freuen uns, dass wir Kunden mit der erfolgreichen SN- sowie mit der im letzten Jahr erfolgten MDC-Integration die Wahl lassen, auf welchen Wegen sie zu Highspeed-Übertragungen bis aktuell 400G migrieren wollen“, sagt André Engel. „Dennoch bleibt die hochfaserige MPO-Verkabelung im Rückraum mit flexibler Modultechnik die zukunfts- und investitionssichere Lösung – wenn sie alle derzeit am Markt erhältlichen Steckverbinder integriert.“   
 **Über die tde – trans data elektronik GmbH**  
Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).   
Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: [www.tde.de](http://www.tde.de/) sowie auf [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/tde-trans-data-elektronik-gmbh/), [Twitter](https://twitter.com/tdeConnect) und [Xing](https://www.xing.com/companies/tde-transdataelektronikgmbh/updates).   
  
**Unternehmenskontakt**tde – trans data elektronik GmbH, Vertriebsbüro Dortmund  
André Engel, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46, D - 44135 Dortmund  
Tel. +49 231 160480, Fax +49 231 160933, [info@tde.de](mailto:info@tde.de), [www.tde.de](http://www.tde.de/)

**Pressekontakt**epr – elsaesser public relations, Maximilianstraße 50, D - 86150 Augsburg

Frauke Schütz, Tel: +49 821 4508 7916, [fs@epr-online.de](mailto:fs@epr-online.de)

Elke Thiergärtner, Tel: +49 821 4508 7912,[et@epr-online.de](mailto:et@epr-online.de)

www.epr-online.de